

矽品捐贈中興大學先進測試設備 共創臺灣高頻封測技術未來

[感謝本校秘書室媒體公關組提供資料](#)

隨著人工智慧(AI)技術的快速進步，先進封裝測試成為產業中相當重要的一環，而矽品精密在產業中的關鍵影響力亦愈發顯著。國立中興大學 2 月 25 日舉辦矽品精密天線電波測試設備捐贈儀式，矽品精密由王愉博副總代表捐贈，興大研發長宋振銘教授與工學院陳志銘副院長受贈。藉由此次捐贈產學攜手強化學界在 5G 毫米波 (mmWave) 與未來 6G Sub-THz (次太赫茲) AiP (Antenna in Package, 天線封裝) 領域的研究與教學應用，讓學生在學期間即能接觸產業級測試環境，透過產學協作佈局 6G 技術人才培育。

隨著 5G、6G 無線通訊技術的發展，AiP 已成為高頻封裝的關鍵技術，確保天線性能與訊號完整性至關重要。矽品捐贈的天線電波測試設備整合高精度擺臂與轉盤控制，具備 1° 定位解析度，可進行半球面 3D 天線訊號量測，完整評估天線封裝基板內的傳輸特性，此高精度測試設備能提升毫米波與 AiP 驗證能力，深化學研能量接軌產業。

該設備目前可支援 28GHz/39GHz 5G 毫米波行動通訊、60GHz 無線電與手勢雷達、77GHz 汽車雷達等應用，並可升級放大器與接收模組，擴展至 100GHz-300GHz 6G Sub-THz AiP 測試，將產業級測試設備導入學界，加速新一代無線通訊技術的研究與驗證。

興大研發長提到設備將應用於中興大學電子材料、半導體封裝、無線通訊等相關課程與專題實驗，學生可透過材料選用、線路設計與天線訊號分析等實作訓練，深入理解不同製程對高頻訊號的影響，培養符合產業需求的技術能力。

矽品精密王愉博副總經理表示：「高頻封裝測試能力是 5G/6G 時代及未來產業的核心關鍵，矽品此次捐贈的設備，將協助學生掌握最新測試技術，縮短學用落差，未來能無縫銜接產業需求，加速半導體封測領域人才培育。」

矽品長期投入技術與人才發展，除推動學研合作，亦提供企業導師計畫，與中興大學工學院合作開辦半導體構裝材料與製程實務課程，讓學生吸收業界經驗。本次捐贈不僅為產學合作搭建更堅實的橋樑，更進一步推動台灣在 6G 時代的技術競爭力，為臺灣半導體與通訊產業培育高階技術人才。